香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用,並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要 約。



## Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號:1400)

補充公告 有關根據特別授權 配售可換股債券

配售代理



謹此提述本公司日期為二零一八年十一月十二日之公告(「**該公告**」),內容關於 (其中包括)根據特別授權配售可換股債券。除另有界定外,本公告使用之詞彙 應具有該公告界定之相同意義。

本公司謹此在本公告披露更多可換股債券的資料。

## 所得款項用途及本集團之負債

於二零一八月六月三十日,本集團有短期借款約人民幣418.8百萬元(相當於約475.9百萬港元),包括有抵押銀行借款約人民幣222.2百萬元(相當於約252.5百萬港元)、無抵押銀行借款約人民幣21.5百萬元(相當於約24.4百萬港元)及無抵押債券約人民幣175.1百萬元(相當於約207.6百萬港元)。

本集團於二零一八年六月三十日之有抵押銀行借款約人民幣222.2百萬元(相當於約252.5百萬港元)包括向中國七間金融機構借入之定期貸款約人民幣106.9百萬元及循環貸款約人民幣115.3百萬元,以本集團之物業、廠房及設備、租賃土地及土地使用權為抵押,而該等借款已用作中國紡織業務之一般營運資金。於本公告日期,前述有抵押銀行借款之未償還本金及利息分別約為人民幣213.1百萬元(相當於約242.2百萬港元)及約為人民幣7.1百萬元(相當於約8.1百萬港元),須應要求償還。本集團於二零一八年六月三十日之無抵押銀行借款約人民幣21.5百萬元(相當於約24.4百萬港元),乃向中國兩間地方銀行借入之循環貸款,用作中國紡織業務之一般營運資金。於本公告日期,前述無抵押銀行借款之未償還本金及利息分別約為人民幣21.5百萬元(相當於約24.4百萬港元)及約為人民幣0.7百萬元(相當於約0.8百萬港元),須應要求償還。

本公司已與中國地方銀行磋商還款時間表,而本集團擬使用其中國之內部資源,償還有抵押銀行借款及無抵押銀行借款。下文列載於二零一八年十月三十一日銀行借款未償還金額之協定還款時間表:

	千港元
3個月內之還款	10,568.8
超過3個月但6個月內之還款	6,022.7
超過6個月但9個月內之還款	6,022.7
超過9個月但12個月內之還款	6,022.7
超過12個月但2年內之還款	104,204.5
超過2年但5年內之還款	134,846.5
總計	267 697 0
邓 司	267,687.9

於二零一八年六月三十日,本集團約有人民幣28.6百萬元之銀行及現金結餘。董事認為本集團之現有現金連同本集團在中國營運產生之現金,足以於未來十二個月按銀行借款之還款時間表還款,故此無須分配配售事項之所得款項以償還銀行借款。

於二零一八年六月三十日,本集團之短期無抵押債券合共約人民幣175.1百萬元(相當於約207.6百萬港元),發行予一名公司債券持有人及57名個人債券持有人,而該等債券之所得款項已用於香港之一般營運資金。於本公告日期,該等無抵押債券之未償還本金及利息分別約為143.0百萬港元(其中約32.0百萬港元已到期及約111.0百萬港元將於其後12個月到期)及約為1.5百萬港元。於該等債券到期日,預期總未償還本金及利息將分別約為143.0百萬港元及約為6.1百萬港元。前述未償還金額包括關於一項債券之清償契據(「清償契據」)之未償還金額約92.6百萬港元(見本公司日期為二零一八年四月十九日之公告所述),最後一期將為二零一九年六月二十九日,而於本公告日期之未償還金額約為72.0百萬港元。下文列載於二零一八年十月三十一日短期無抵押債券之未償還金額之協定還款時間表:

	千港元
逾期	32,000
3個月內之還款	39,950
超過3個月但6個月內之還款	43,680
超過6個月但9個月內之還款	33,280
超過9個月但12個月內之還款	150
總計	149,060

本公司預期未來12個月將需要資金約160.0百萬港元,主要包括:(i)償還短期無抵押債券及相關利息約149.1百萬港元;及(ii)本集團於香港之一般營運資金約10.9百萬港元。本集團於未來12個月將需要之資金建議由以下各項提供:(i)發行債券,約65.2百萬港元;及(ii)配售可換股債券所得款項淨額,約94.8百萬港元。本公司計劃不時發行債券,預期本公司可於二零一九年六月三十日前發行約65.2百萬港元之債券。該等所得款項將主要用於結付部分無抵押債券(並無以配售事項之所得款項結付)。

完成配售事項後,配售事項之所得款項將用於以下用途:(i)結付緊接配售事項完成後逾期之無抵押短期債券約32.0百萬港元及(ii)於債券到期日結付部分無抵押債券約51.9百萬港元(包括於清償契據下到期之餘額約40.0百萬港元)及(iii)餘下所得款項10.9百萬港元用作一般營運資金,其中約3.5百萬港元將為薪金開支(包括董事薪酬)、約2.1百萬港元將用作香港物業之租金開支及約5.3百萬港元將用於法律及專業開支及其他行政開支。

所得款項淨額將不會分配售予償還其他借款。預期配售事項之完成日期將為 二零一九年三月及本公司於本公告日期已成功與已逾期之債券之債券持有人 磋商,完成配售事項後方還款。

## 本公司於過去十二個月之集資活動

就根據一般授權配售股份(於二零一八年五月十七日宣佈)而言,本公司募集約30.5百萬港元,其中約4.9百萬港元用於薪金開支、租金開支、法律及專業開支及其他行政開支及約25.6百萬港元乃用於償還債務。

## 配售事項之因由

除該公告所披露者外,董事認為配售事項符合本公司及股東之整體利益,而配售事項可為本公司募集更多資金的良機,理由如下:(i)可換股債券之利息低於前述待償還之債券利息;(ii)倘可換股債券轉換為股份,本公司可改善其負債狀況;及(iii)配售事項將提供即時之資金,亦不會即時攤薄現有股東之股權,而於行使可換股債券所附之轉換權時,可擴大本公司股本基礎,利好本公司之長期發展。董事亦認為對本公司之財務狀況或負債狀況有正面影響,因為:(i)大部分配售事項之所得款項將用於償還無抵押債券,使該等短期負債將成為長期負債;及(ii)利息成本將較前述待償還之債券利息為低。董事透過審閱多間聯交所上市公司於二零一八年八月一日至配售協議日期約三個月期間,宣佈發行可換股債券來進行研究,並認為可換股債券的利率處於市場利率。

本公司已考慮多個其他集資方案,包括銀行借款、配售新股份及供股。

本公司已接觸多間銀行,嘗試取得銀行借款,贖回及償還未償還之債務。然而,經過與銀行的多輪磋商及銀行審視本公司最新刊發之財務報表後,該等銀行拒絕提供銀行借款予本公司,主要由於:(i)本集團在香港並無活躍之營運附屬公司;(ii)本集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度錄得虧損;及(iii)本集團於香港並無資產可作為質押之抵押品。

本公司已接觸多間金融機構,探討配售股份之可行性,惟於本公告日期,本公司未能協定董事認為符合本公司及股東整體利益之配售股份條款。再者,配售股份將立即攤薄現有股東之股權,卻不會提供機會予彼等參與本公司擴大資本基礎。

董事亦考慮過供股之可行性。本公司已與多名潛在包銷商磋商供股,惟於本公告日期,本公司未能就供股之條款達成共識。

承董事會命 滿地科技股份有限公司 代理主席兼執行董事 李佳音

香港,二零一八年十一月二十三日

於本公告日期,執行董事為李佳音女士、吳健雄先生、林清雄先生、嚴希茂先生 及蘇毅超先生;及獨立非執行董事為陳瑞華先生、劉順剛先生及林宇剛先生。